

北京燕东微电子股份有限公司 关于募投项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、项目基本情况

根据《北京燕东微电子股份有限公司招股说明书》及其他相关文件披露，公司将使用募集资金投资“基于成套国产装备的特色工艺 12 吋集成电路生产线项目”，项目基本情况如下：

1.实施主体：全资子公司北京燕东微电子科技有限公司；

2.总投资：人民币 75 亿元；

3.项目建设内容：利用现有的净化厂房和已建成的厂务系统和设施，进行局部适应性改造，并购置三百余台套设备，建设以国产装备为主的 12 英寸晶圆生产线；

4.项目目标：月产能 4 万片，工艺节点为 65nm，产品定位为高密度功率器件、显示驱动 IC、电源管理 IC、硅光芯片等；

5.项目周期：

（1）一阶段 2023 年 4 月试生产，2024 年 7 月产品达产；

（2）二阶段 2024 年 4 月试生产，2025 年 7 月项目达产。

二、募投项目进展情况

燕东微 12 英寸晶圆生产线一阶段于 2023 年 4 月底实现了试生产，首款试生

产的功率 SBD 器件良率达到预期，预计年内产能达到 1 万片/月。

三、对公司的影响及风险提示

本项目利用现有净化厂房和已建成的厂务系统设施，进行局部适应性改造，购置三百余台套设备，建设以国产装备为主的 12 英寸晶圆生产线，项目达产后生产能力将得到提高，增强公司竞争力，更好维护全体股东的权益。

项目投产后需要经历一段时间的产能爬坡期，若产能爬坡不及预期以及受未来可能存在的市场环境需求变化，将导致投资项目预计效益无法按计划实现的风险。公司将密切关注产线实际运行情况，若出现重大风险或可能出现重大风险，公司将根据相关规则及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日